

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231227

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：KrF/ArF 光刻胶项目解读会
参与单位名称及人员姓名	2023年12月26日15:30~16:30：中欧基金：李帅；浙商基金：王斌；招商基金：袁哲航；长城基金：储雯玉；圆信永丰基金：胡春霞、范研；兴全基金：李楠竹、季文华、邓荃文；易通投资：夏济舟；上投摩根基金：倪权生、翟旭；理成资产：孙兴华、杨帆；诺安基金：简桢；南方基金：吴春林、郑勇；建信基金：许杰、杨荔媛；嘉实基金：李昊泽、谢泽林；华夏基金：胡斌；国泰基金：胡运昶、高司民；光大保德信基金：杨一飞、李心宇；工银瑞信基金：张新磊；高毅资产：张新和、赵浩；富国基金：沈衡等366名投资者及证券人员
时间	KrF/ArF 光刻胶项目解读会：2023年12月26日15:30~16:30
地点	公司9楼会议室
上市公司接待人员姓名	2023年12月26日15:30~16:30：总经理朱顺全先生、KrF/ArF 光刻胶项目负责人刘博士、董事会秘书杨平彩女士、投资者关系经理朱梦茜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层及业务人员与投资者就公司 KrF/ArF 光刻胶业务的情况及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>问 1：请问公司晶圆光刻胶业务人才团队情况如何？</b></p> <p>答：目前公司已组建了约 160 人的晶圆光刻胶业务人才团队，包括内部调转的有丰富经验的研发工程师，以及在高校新招入的优秀人才等。其中研发人员约一百人，包括十余名博士和四十余名硕士。</p> <p><b>问 2：请问公司有哪些积累帮助高端晶圆光刻胶项目快速推进？</b></p> <p>答：公司深耕进口替代类关键材料领域，拥有超 20 年有机合成、高分子聚合、材料工程化、纯化等技术积累，同时在其中的 OLED 显示用光刻胶 PSPI 和封装光刻胶的开发和应用过程中积累了丰富经验，熟悉光刻胶产品的开发、应用流程及客户应用需求。因此，公司在一年半的时间内，已具备独立开发高端晶圆光刻胶核心原材料一功能单体，主体树脂和含氟树脂（浸没式 ArF 光刻胶的核心组分），光致产酸剂、淬灭剂及其它助剂等光刻胶上游原材料的能力，同时已开发出 13 款高端晶圆光刻胶产品，包括 6 款浸没式 ArF 光刻胶和 7 款 KrF 光刻胶产品，并有 5 款光刻胶产品已在客户端进</p>

行送样，市场反馈正向。

**问 3：公司布局晶圆光刻胶业务有哪些优势？**

答：1、在上游供应链端，公司拥有深厚的有机合成、高分子合成技术积累，具备高端晶圆光刻胶原料自主合成的能力；2、在配方开发方面，公司具备 OLED 显示用光刻胶 PSPI 和封装光刻胶的成熟的开发经验，帮助公司在较短时间内开发出 13 款高端晶圆光刻胶产品并推出 5 款送样验证；3、在产业化建设方面，具备丰富的半导体材料产业化经验并已同步进行产业化布局，提前储备多台光刻胶关键量产设备，规模化产线建设快速推进，预计明年四季度建成；4、在下游客户端方面，公司深刻理解在客户端稳定供应的底层逻辑，与下游客户—国内主流晶圆厂建立了良好的客情关系，为公司新产品的开发、验证评估及未来的量产导入提供了有力支持。

**问 4：公司晶圆光刻胶上游单体供应是如何解决的？**

答：对于国内有供应商的单体，公司会以采购为主。但高端晶圆光刻胶核心单体基本上没有商业化，通常为原厂和其供应商进行定制开发，不具备购买条件，公司则通过自主合成的方式解决供应问题。

**问 5：晶圆光刻胶的验证流程和周期需要多久？**

答：晶圆光刻胶在客户端的验证流程与其他半导体材料类似，都需要经过模拟测试、小批量测试、中大量测试、量产导入环节，但晶圆光刻胶产品的验证资源相对更有限，同时产品若需持续改进也要花费时间，一般晶圆光刻胶产品从送样验证到导入需要花费 1~2 年的时间。

**问 6：公司晶圆光刻胶项目产能规划和建设进度如何？**

答：公司实行技术研发和品质管控、量产线建设的同步推进，其中：单体、树脂、光致产酸剂、淬灭剂合成的小规模混配线建设已基本完成，年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目按计划推进，预计于明年第四季度完成建设。

**问 7：公司光刻胶产线对设备端的要求高吗？**

答：高端晶圆光刻胶产线对生产设备的要求比较苛刻，如在金属离子控制方面，面板光刻胶或者封装光刻胶对金属离子控制的要求在 100~10PPb 的级别，而高端晶圆光刻胶对金属离子控制要求则更加严格，普通的反应釜难以满足这一类要求。公司目前已经解决了关键量产设备储备问题，相关设备都严格到达了高端晶圆光刻胶的生产要求，为公司晶圆光刻胶产业化建设的推进和后续建成后稳定量产提供了有力保障。

**问 8：公司如何解决晶圆光刻胶扩大生产可能带来的生产品质不稳定的问题？**

答：1、公司拥有一支经验丰富的工程化建设团队，成功完成了彩色聚合碳粉及多款半导体材料的产业化建设，为公司晶圆光刻胶产业化建设打下坚实的基础。2、公司 CMP 抛光垫产品在下游晶圆厂客户端稳定批量供应多年，深刻理解半导体材料稳定量产的底层逻辑，半导体行业的生产和品管

	理念已和客户高度对齐。3、公司高度重视规模化生产的品质管控，通过已实现规模化的半导体材料项目，持续培养、储备生产和品管人员，现已拥有专业的生产和品质管理团队，保障公司量产产品品质稳定。
附件清单	无
日期	2023年12月26日